目 次

序	文		
---	---	--	--

第1章	真空	の科学	1
1.1	真空	の特徴	1
1.2	気体(D考え方	6
1.3	気体が	分子運動論	8
1.3		【体の圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1.3		《体分子速度の分布則	_
1.3	3.3 平	^z 均自由行程····································	5
1.4	気体?	分子運動論から導かれる諸関係	9
1.4		₹面 (壁面)をたたく気体分子数	
1.		青浄な固体表面の吸着分子層の形成時間·······2	
1.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ş発·······2	
1.4		(遷移	
1.	4.5	新送現象····································	4
第2章	真空	システム	29
第2章		システム2 ダクタンス2	
2.1	コン		29
2.1	コン: 1.1 *#	ダクタンス2	29 10
2.1 2. 2.	コン: 1.1	ダクタンス	19 10 11
2.1 2. 2. 2.	コン: 1.1 料 1.2 タ 1.3 根	ダクタンス	99 10 11 17
2.1 2. 2. 2.	コン: 1.1 料 1.2 タ 1.3 根 1.4 コ	ダクタンス 2 h性流および乱流 3 →子流 3 t散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3	19 10 11 17 18
2.1 2. 2. 2. 2. 2.	コン 1.1 料 1.2 タ 1.3 披 1.4 = 実効	ダクタンス 2 特性流および乱流 3 子子流 3 は散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3 1ンダクタンスの合成 3	29 30 31 37 38
2.1 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	コン 1.1 料 1.2 夕 1.3 根 1.4 二 実効 2.1 到	ダクタンス 2 特性流および乱流 3 子子流 3 は散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3 コンダクタンスの合成 3 俳気速度と到達圧力 4	29 30 31 7 8 11
2.1 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	コン 1.1 料 1.2 夕 1.3 根 1.4 二 実効 2.1 到 2.2 名	ダクタンス 2 特性流および乱流 3 オ子流 3 は散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3 エンダクタンスの合成 3 俳気速度と到達圧力 4 創達圧力と実効排気速度 4	29 10 13 17 18 11 13
2.1 2. 2. 2. 2. 2.2 2.2 2.3	コン 1.1 料 1.2 夕 1.3 根 1.4 二 実効 2.1 子 2.2 名 排気	ダクタンス 2 特性流および乱流 3 プ子流 3 は散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3 コンダクタンスの合成 3 俳気速度と到達圧力 4 資達圧力と実効排気速度 4 5・種真空ポンプにおける到達圧力と実効排気速度 4	19 10 17 18 11 13 16
2.1 2. 2. 2. 2. 2.2 2.3 2.3	コン 1.1 を 1.2 が 1.3 を 1.4 を 2.1 要効 2.1 を 4 2.2 を 4 3.1 】	ダクタンス 2 特性流および乱流 3 テ子流 3 は散現象としてパイプ内ガスの流れを考える 3 コンダクタンスの合成 3 俳気速度と到達圧力 4 野達圧力と実効排気速度 4 系複真空ポンプにおける到達圧力と実効排気速度 4 系設計のポイント 4	29 30 31 37 38 31 31 33 36

2.4 超	高真空システムと極高真空システム56
2.4.1	超高真空・極高真空とは56
2.4.2	排気と放出ガス速度58
2.4.3	ガス放出速度の低減61
2.4.4	超高真空, 極高真空用ポンプ67
2.4.5	超高真空システム67
2.4.6	極高真空システム70
2.5 真	空部品73
2.5.1	フランジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.5.2	真空パルブ82
2.5.3	真空導入部品85
2.6 真	空材料89
2.6.1	金属材料89
2.6.2	非金属材料105
2.6.3	ガス121
2.6.4	真空ポンプ油136
2.7 極	高真空装置用の材料とガス放出159
2.7.1	極高真空技術の現状 159
2.7.2	極高真空装置用の材料
2.7.3	ガス放出の評価と制御
第3章 真	空ポンプ 169
	真空ポンプの種類と分類
3.1.2	真空ポンプ・・・・・・・169
3.1.3	真空ポンプの将来184
3.2 油	回転ポンプ
3.2.1	油回転ポンプとは
3.2.2	形式および構造
3.2.3	排気速度および到達圧力193
3.2.4	駆動動力
3.2.5	木蒸気対策195
3.2.5 3.2.6	水蒸気対策·······195 腐食ガス対策······197
	木蒸気対策195

<u> 月 次</u>

3.3 ル	ーツポンプ 200
3.3.1	ルーツポンプとは
3.3.2	構造および原理 200
3.3.3	排気速度および到達圧力 202
3.3.4	駆動動力
3.3.5	補助ポンプと温度上昇 204
3.3.6	吸入気体の種類による影響206
3.3.7	起動方法
3.3.8	腐食性ガス対策
3.3.9	ポンプの取扱いの注意と試験方法 208
3.4 ド	ライ真空ポンプ 209
3.4.1	ドライ真空ポンプとは 209
3.4.2	ニーズと歴史210
3.4.3	各種の DVP とその特徴
3.4.4	スクリューポンプ
3.5 油	広散ポンプ
3.5.1	油拡散ポンプとは
3.5.2	構造および原理······ 236
3.5.3	排気機構239
3.5.4	排気特性240
3.5.5	作動油245
3.5.6	作動油の逆流245
3.5.7	パッフル247
3.6 夕-	ーボ分子ポンプ249
3.6.1	発展の経過249
3.6.2	排気作用の基本特性252
3,6.3	構造255
3.6.4	性能および機能の特徴
3.6.5	最近の開発動向260
3.7 クラ	ライオポンプ 268
3,7.1	クライオポンプとは268
3.7.2	小型冷凍機付クライオポンプ(機械式クライオポンプ) 268
3.7.3	構造および排気の原理
3.7.4	性能
3.7.5	交差圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3.7.6	到達圧力	
3.7.7	17	
3.7.8		
3.7.9	冷凍機	
	冷凍機の性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	クライオポンプへの熱負荷	
3.7.12	ヘリウム圧縮機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	284
3.8 スノ	ペッタイオンポンプ	
3.8.1	スパッタイオンポンプとは	
3.8.2	構造と動作原理	
3.8.3	特性······	
3.8.4	ポンプの寿命と処置	
3.8.5	超高真空排気	
3.8.6	最近の使用法	292
3.9 チョ	タンサブリメーションポンプ	293
3.9.1	構造と動作原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.9.2	排気速度特性 ·····	
3.9.3	使用法	295
	空計測	
4.1 全月	王計・分圧計の種類と利用法	
4.1.1	全圧計の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.1.2	基本となる真空計	
4.1.3	分圧計	
4.1.4	真空計の利用法	
4.1.5	真空計の選定法	303
4.2 熱伝	· 漢真空計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	306
4.2.1	熱伝導真空計における気体の熱伝導	
4,2.2	熱電導真空計の特徴	
4.2.3	ピラニ真空計	
4.2.4	熟電対真空計	
4.2.5	その他の熱伝導真空計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 315
4.3 電	離真空計	316
4.3.1	電離真空計の分類	31€
4 3.2	執陰編實離直空計の動作原理	317

	熟陰極電離真空計の感度係数と比感度係数321
	熱陰極電離真空計の特性324
4.3.5	熱陰極電離真空計の測定誤差要因と使用上の注意
4.3.6	その他の熱陰極電離真空計
4.3.7	冷陰極電離真空計 333
4.4 スセ	プニングローター真空計······· 335
4.4.1	スピニングローター真空計とは 335
4.4.2	測定ヘッドの構造と作動機構
4.4.3	SRG に保わる温度の問題
4.4.4	気体運動論に関連して吟味すること338
4.4.5	SRG の長所と短所 341
4.5 隔距	莫真空計343
4.5.1	キャパシタンス・マノメータの基本構造 343
4.5.2	質量流量計としての応用347
4.6 全月	E計の校正349
4.6.1	校正の必要性と方法349
4.6.2	わが国における真空領域の圧力標準 349
4.6.3	これからの圧力標準354
4.7 極雨	高真空全圧計とその校正361
4.7.1	
4.7.2	冷陰極放電を利用した真空計 361
4.7.3	感度係数 S の小さな熱陰極電離真空計 363
4.7.4	大きな感度係数 S を持つ極高真空計 369
4.7.5	極高真空計の校正373
4.8 四村	鏨子マスフィルタ377
4.8.1	四極子マスフィルタとは377
4.8.2	QMF の原理377
4.8.3	残留ガス分析の重要性380
4.8.4	QMF の応用 ······381
4.8.5	極高真空の分圧測定386
	空装置の管理389
	空装置のトラブルとその対策389
5.1.1	Name to the second seco
5.1.2	真空機器の取扱い注意, トラブル対策, 保守点検391

5.1.3 半導体プロセスでの有害ガスによるポンプの故障,対策,取扱い 400
5.1.4 真空装置のトラブルと保守点検 404
5.2 各種の真空装置における洩れ探し
5.2.1 洩れ探しとは415
5.2.2 主な漏洩試験方法と適用例
5.2.3 漏洩試験適用時の留意点 418
5.2.4 漏洩の定量化と問題点 428
5.2.5 機器設計・製作上の問題点と検討
5.3 ヘリウムリークデテクタとその使用技術
5.3.1 ヘリウムリークデテクタおよびその構成 435
5.3.2 ヘリウムリークデテクタの原理 436
5.3.3 校正リーク437
5.3.4 プローブガスにヘリウムガスを用いる理由
5.3.5 リークテスト方法
5.3.6 洩れ量の評価(テスト条件による換算)
5.3.7 応答時間と感度
5.3.8 リークテストの実際(ヘリウムリークデテクタを用いて) 446
5.3.9 装置設計および製作時の留意点
5.3.10 CONTRA FLOW 型リークデテクタ······447
5.4 真空装置の汚染に関するトラブル 450
5.4.1 真空装置の汚染とは 450
5.4.2 汚染および欠陥の種類 450
5.4.3 真空成膜における汚染の考え方 453
5.4.4 真空の質 458
5.4.5 各種汚染と対策
5.4.6 反応性ガス使用装置の汚染 473
5.4.7 汚れ対策とチェック方法 478
5.4.8 ダストによる汚れ 481
5.4.9 メンテナンスおよびクリーニング··························490
5.4.10 汚染除去の対策
第6章 真空を利用した薄膜製造装置497
6.1 真空蒸着法
6.1.1 真空蒸着の原理
6.1.2 蒸着装置と蒸発法 499
6.2 分子線エピタキシー

	_ <u> 周 _ 次</u> _	vii
6.2.1	分子線エピタキシーとは	512
6.2.2	MBE 法と超高真空	512
6.2.3	化合物半導体用 MBE 装置	519
6.2.4	Si 系 MBE 装置······	524
6.2.5	今後の動向	525
6.3 ス/	ペッタ法	529
	スパッタリングとは	
6.3.2	スパッタ現象とその特徴	529
6.3.3	スパッタ方式とその特徴	535
6.3.4		
6.3.5	スパッタリングの利用と新しい可能性	542
6.4 イン	オンプレーティングとその応用技術	544
	イオンプレーティングとは	
	イオンプレーティング法	
	高周波励起イオンプレーティング(RF 法)	
	イオンプレーティングの効果	
	反応性イオンプレーティング	
	デバイスへの応用	
6.4.7	応用技術	556
6.5 イ	オンビームによる薄膜形成	562
	イオンピームとは	
6.5.2	薄膜形成プロセス	564
6.5.3	イオンビームの作用	565
6.5.4	種々のイオンビームによる	578
	ライエッチング技術	
	エッチング特性	
	低温プラズマエッチング	
	光励起エッチング	
6.6.4	ガスエッチング	614
	D 法······	
	CVD 法とは	
6.7.2	CVD 法の概要 ·····	
6.7.3		
6.7.4		
6.7.5	光 CVD 法·····	630

国次

6.7.5	最近の動向	631
第7章 真	空を利用した薄膜製造技術	635
7.1 薄朋	模製造における真空技術	635
7.1.1	薄膜製造技術と真空との関わり	635
7.1.2	薄膜製造における真空の必要性	
7.1.3	MBE 装置 ·····	
7.1.4	Wake 空間と MBE ·····	
7.1.5	スパッタリング装置における真空技術	
7.1.6	放電洗浄······	·· 641
7.2 酸化	化物超伝導体と薄膜化技術	643
7.2.1	酸化物超伝導体とは	·· 64 3
7.2.2	酸化物超伝導体の結晶構造	
7.2.3	酸化物超伝導体薄膜の作成	
7.2.4	基板	
7.2.5	今後の動向	658
7.3 薄服	嘆をンサ	··660
7.3.1	センサ開発の現状と薄膜センサの位置付け	660
7.3.2	センサ薄膜化の特徴	662
7.3.3	センサ材料の薄膜作製方法	664
7.3.4	薄膜センサの代表的実例	667
7.3.5	薄膜センサの今後の動向	670
7.4 セ	ラミックス膜	672
7.4.1	セラミックス膜とは	672
7.4.2	各種セラミックス膜	672
7.4.3	機械的特性の応用	696
7.5 ダイ	イヤモンド薄膜	711
7.5.1	ダイヤモンド合成の歴史	711
7.5.2	ダイヤモンド低圧合成の原理	
7.5.3	ダイヤモンド低圧合成の実際	
7.5.4	低圧合成ダイヤモンドの評価	723
7.5.5	低圧合成ダイヤモンドの応用例	
7.5.6	今後の問題	

第8章 真	空利用装置と利用技術	·733
8.1 電	子顕微鏡における真空技術	·733
	電子顕微鏡の典型的な真空系	
8.1.2	電子顕微鏡技術の進展と真空技術	735
8.2 表	面分析技術における真空技術	737
8.2.1	表面分析技術と真空技術との関わり	
8.2.2	組成分析	
8.2.3	構造解析······	
8.2.4	電子状態	749
8.3 真	空断熱技術	755
8.3.1	真空断熱法とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	755
8.3.2	高真空断熱	755
8.3.3	粉末真空断熱と繊維質真空断熱	758
8.3.4	多層真空断熱	764
8.3.5	その他	770
8.4 ス-	ペースチャンパ	773
8.4.1	スペースチャンバの目的	773
8.4.2	熱真空試験用スペースチャンバ	774
8.4.3	77.44	
8.4.4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
8.4.5	その他のスペースチャンパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	782
8.5 大	型加速器における真空技術	784
8.5.1	真空システムとしての加速器	784
8.5.2	ビームと残留ガスの相互作用ービーム寿命	
8.5.3		
8.5.4	ガス負荷	794
8.5.5	ガス負荷以外のビームによる真空部品への影響	797
8.5.6	その他の注意点	799
8.6 最	近の真空利用	805
8.6.1	真空利用の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8.6.2	食品と真空	
8.6.3	金属と真空	
8.6.4	, 411 - 22	
8.6.5	電気・電子部品と真空	815

第9章	規格等	819
9.1	規格	819
9.2	特許	820
9.3	世界で発行されている雑誌・	823
9.4	単位極質	823